

证券代码：301286

证券简称：侨源股份

公告编号：2026-006

## 四川侨源气体股份有限公司

# 关于拟签署《高纯电子特气与医用气体生产基地项目补充协议》 暨对外投资的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、对外投资概述

四川侨源气体股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月4日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟签署电子级医用级特种气体生产基地投资合作协议暨对外投资的议案》，同意公司与成都新材料产业功能区管委会签订《投资合作协议》，并拟在成都新材料产业化工园区投资电子级医用级特种气体生产基地项目。具体内容详见公司于2025年8月4日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟签署电子级医用级特种气体生产基地投资合作协议暨对外投资的公告》（公告编号：2025-044）。

2025年9月10日，作为上述项目实施主体，公司全资子公司四川侨源乐贸易有限公司及控股子公司四川侨源乐科技有限公司均已完成工商登记手续，并取得了彭州市行政审批局核发的营业执照。具体内容详见公司于2025年9月10日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对外投资进展暨设立子公司并取得营业执照的公告》（公告编号：2025-052）。

### 二、对外投资进展情况

2026年3月11日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟签署<高纯电子特气与医用气体生产基地项目补充协议>的议案》，公司与成都新材料产业功能区管委会签署《高纯电子特气与医用气体生产基地项目补充协议》（以下简称“《补充协议》”）。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上

市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等规定，该议案无需提交股东会审议。

### 三、交易对方基本情况

- 1、交易对方名称：成都新材料产业功能区管委会
- 2、法定地址：彭州市致和街道东三环路三段 999 号发展大厦 B 座
- 3、单位性质：彭州市人民政府的派出机构
- 4、关联关系说明：公司与成都新材料产业功能区管委会不存在关联关系

### 四、《补充协议》的主要内容

甲方：成都新材料产业功能区管委会

乙方：四川侨源气体股份有限公司

2025 年 8 月 4 日，甲乙双方签订《电子级医用级特种气体生产基地项目投资合作协议》（以下简称“原协议”）。协议签订后，乙方基于公司整体战略发展规划需要，拟扩大项目建设规模，现经双方协商一致，特签署本《补充协议》。

第一条 将原协议第一条内容变更为：

“项目名称：高纯电子特气与医用气体生产基地项目（最终项目名称以乙方或项目公司在行政主管部门立项备案并审批通过为准）。”

第二条 将原协议第二条内容变更为：

“项目内容：项目计划总投资 4.86 亿元，建设 2 万吨/年电子级二氧化碳、2 万吨/年医用级二氧化碳、4 万吨工业级二氧化碳、1000 标方/小时的氢气回收提纯装置，建设 30000 标方/年电子级氮气、3000 标方/年氩气提纯生产线、2000 吨/年超纯氧、氩、氮提纯生产线，40 万瓶/年标准气及混合气（部分含氟激光气体）生产线以及相关配套设施。”

第三条 将原协议第三条内容变更为：

“项目拟选址及面积：拟选址成都新材料产业化工园区内，占地约 90 亩。项目用地位置、界址等具体内容由乙方按照法定程序依法取得为准。”

第四条 将原协议第四条内容变更为：

“项目投资额：项目投资总额约 4.86 亿元（大写：肆亿捌仟陆佰万元整），其中固定资产投资总额约 4 亿元（大写：肆亿元整）。本协议所称固定资产投资包括建筑物、附着物、生产性固定资产的投入；本协议所涉及的币种均为人民币。”

第五条 本补充协议与原协议不一致的，以本补充协议约定为准，本补充协议未作约定的，按原协议执行。

第六条 本补充协议是原协议不可分割的组成部分，与原协议具有同等效力。

第七条 本补充协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

## 五、签署补充协议的目的、对公司的影响及风险

### （一）签署补充协议的目的

本次签署的《补充协议》是公司抢抓半导体产业国产替代重大机遇、落实整体战略发展规划的重要举措，结合成都新材料产业功能区产业发展规划及项目地块实际情况，与成都新材料产业功能区管委会协商一致后扩大项目建设规模，将原分两期实施的项目调整为整体同步建设，进一步丰富高端电子特气产品布局、提升产能规模，聚焦超大规模集成电路等领域关键电子特气产品需求，推动公司从传统工业气体供应商向高端电子材料综合服务商转型，同时助力区域电子特气产业链发展，巩固并提升公司在行业内的核心竞争地位。

### （二）对公司的影响

本次签署的《补充协议》拟扩大项目建设规模系双方友好协商的结果，是公司在现有技术积累、客户资源和产业链配套优势上的战略升级，聚焦超大规模集成电路、先进封装、新型显示等领域急需的关键电子特气产品，有利于促进公司中长期战略规划逐步落地，进一步扩大市场份额，提升公司综合竞争力，对公司主营业务的持续发展有积极促进作用，短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，投产后预计将进一步提升公司盈利能力，对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。公司本次对外投资的资金来源为自有或自筹资金，不存在损害公司或股东利益的情形。

### （三）存在的风险

1、协议重大变更及履约风险。本次签署的《补充协议》是对原投资合作协议的重大调整，总投资额与用地规模大幅增加。投资者应特别注意，原协议中关于项目建设

周期、经济效益承诺、违约责任等多项与投资规模及进度紧密相关的条款并未随本次变更而修订。

2、项目建设风险。该项目涉及的用地需按照国家现行法律法规及常规的用地程序办理，采取公开挂牌出让方式取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交面积、价格及取得时间存在不确定性。此外，项目建设需取得相关部门环评、安评、能评的批复文件，如因国家或地方有关政策调整、项目备案等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

3、其他风险。本次投资项目是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但宏观环境、行业政策、市场需求等外部因素及公司内部经营管理、业务拓展等存在一定的不确定性，可能存在投资计划及收益不达预期的风险。

## 六、其他事项

公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，及时履行相应审议程序并披露相关进展信息，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

## 七、备查文件

- 1、第五届董事会第二十次会议决议；
- 2、《高纯电子特气与医用气体生产基地项目补充协议》。

特此公告。

四川侨源气体股份有限公司董事会

2026年3月11日